



技术要求:

- Ⓐ 1. 热处理质量符合 JB/T 1255 标准,
垫片经 200℃(S0) 回火, 硬度 59 ~ 64HRC, 金相组织马氏体 1~4 级;
- 2. 组装时残留异物量在 0.2mg 以下 (采用网孔尺寸为 10μm 滤网称重), 最大颗粒物尺寸 ≤ 600μm;
- 3. 零件确保无飞边, 毛刺, 裂纹, 锐边, 锈蚀的外观缺陷;
- 4. 未注尺寸公差按照 GB/T 1804 m 级执行。

	垫片	AS44×55×3
	GCr15	